07 Электронные и оптические свойства аморфных пленок *a*-C⟨N⟩ с гранулированной структурой

© В.Н. Варюхин, Т.А. Дьяченко, В.Д. Окунев, Н.Н. Пафомов, А.Л. Плехов, Е.И. Шемченко

Донецкий физико-технический институт НАН Украины E-mail: okunev@mail.fti.ac.donetsk.ua

Поступило в Редакцию 12 октября 2004 г.

Исследованы углеродные аморфные пленки a-C $\langle N \rangle$, полученные методом магнетронного распыления графитовой мишени в атмосфере азота с температурными зависимостями электропроводности ($\ln \sigma \sim T^{1/2}$ при T < 280 K), характерными для гранулированных систем. Из измерений термо-ЭДС, проводимости и оптического поглощения сделан вывод о том, что гранулированная структура пленок обусловлена наличием в углеродной (С) графитоподобной матрице кластеров с металлической проводимостью нанометрового размера, образующихся на основе γ -углерода. Их концентрация экспоненциально увеличивается с ростом температуры осаждения.

Углеродные пленки благодаря сочетанию уникальных свойств привлекают пристальное внимание исследователей [1]. Одно из перспективных направлений связано с изучением алмазоподобных пленок, легированных азотом, где усилия сконцентрированы на возможности создания технологии покрытий β -C₃N₄ [2–4].

В проблеме алмазоподобных пленок выделяются работы по формированию системы кластеров с металлической проводимостью в диэлектрической матрице, представляющих интерес для наноэлектроники [5,6]. При этом широко используется тенденция к кластеризации атомов (С) с одинаковым типом координации (с sp^3 -, sp^2 - и sp-гибридными состояниями) [7,8]. При наличии цепочечных, плоских и алмазоподобных структурных фрагментов углеродная основа пленок играет роль стабилизирующей матрицы, благодаря которой кластеры

1

металла имеют минимальную плотность поверхностных состояний, приобретая, к тому же, термодинамическую и химическую устойчивость [5]. В данной работе показано, что систему кластеров с металлической проводимостью в изолирующей матрице аморфного углерода можно создать без введения в его состав примесей металла, синтезируя пленки в атмосфере азота.

Пленки *a*-С(N) толщиной $0.9 \div 5.0 \,\mu$ т получены магнетронным распылением графитовой мишени в атмосфере чистого азота при давлении 75 ÷ 100 mTorr (в таких условиях обычно растут графитоподобные слои с *sp*²-связями [9]). Температура стеклянных подложек (*T_s*) изменялась от 20 до 450°С.

При линейных вольт-амперных характеристиках в электрических полях F < 30 V/cm полученные образцы имели температурные зависимости электропроводности вида

$$\sigma \approx \exp\left[-\left(\frac{T_0}{T}\right)^{\xi}\right],\tag{1}$$

где $\xi \simeq 1/2$ (рис. 1). В соответствии с дифференциальным методом анализа безразмерной энергии активации $\omega(T) = T^{-1}\partial \ln \rho(T)/\partial T^{-1} =$ $= m + \xi (T_0/T)^{\xi}$ [10], где $\rho = 1/\sigma$, точное значение показателя степени ξ для образцов с $T_s = 20$, 250, 350, 450°C составляет 0.48, 0.45, 0.46, 0.45. Более простой метод [11], заключающийся в анализе функции $\ln \ln \rho = f (\ln T) = \xi \ln T_0 - \xi \ln T + \ln(1 + (T/T_0)^{\xi} \ln \rho_0)$, дает значения $\xi = 0.49$, 0.46, 0.46, 0.45 соответственно, что также близко к величине 0.5. Зависимость $\ln \sigma \sim -T^{-1/2}$ наблюдается при T < 280 К. С ростом T_s проводимость пленок увеличивается на 4 (T = 300 K) или 7 (T = 100 K) порядков, а параметр T_0 уменьшается от $2 \cdot 10^5$ до $2 \cdot 10^4$ К.

Наиболее вероятная природа $\xi = 1/2$ связана с туннелированием электронов между малыми кластерами с металлической проводимостью в гранулированных средах [12]. Механизм электропроводности, связанный с наличием кулоновской щели в спектре состояний систем с неупорядоченной структурой, имеющий также $\xi = 1/2$, наблюдается при T < 80 K [13,14], когда эта щель еще не замывается тепловыми возбуждениями.

В пространстве размерности ν для прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка $\sigma(T) = \sigma_0 \exp[-(T_0/T)^{\xi}]$ [15], где $\xi = 1/(\nu + 1)$,



Рис. 1. Температурные зависимости удельной электропроводности образцов, полученных при различных температурах осаждения (T_s) пленок на стеклянные подложки. T_s , °C: I - 450; 2 - 350; 3 - 250; 4 - 20. На вставке: связь термо-эдс (при T = 300 K) с электропроводностью (при T = 300 K) образцов.

и при $\nu = 1$ значение $\xi = 1/2$. Однако одномерная прыжковая проводимость в карбинах с одномерными цепочками и очень высоким удельным сопротивлением наблюдается при T < 40 K [16].

Определяя сопротивление пленок, связанное с туннелированием носителей заряда между металлическими кластерами на основе простой модели [17], в которой кластеры с одинаковым линейным размером D и толщиной γD формируют правильную решетку, можно записать: $\rho = \rho_0 \exp(d/d_0)$, где $d = D[(C_m/\gamma)^{-1/3} - 1]$ — среднее расстояние между металлическими кластерами при их концентрации C_m , и тогда

$$\rho = \rho_0 \exp\left[\frac{D}{d_0} \left(\frac{1}{\gamma} C_m\right)^{-1/3} - 1\right].$$
 (2)

Уменьшение ρ с повышением T_s , при сохранении зависимости $\rho(T)$ вида $\ln \rho \sim T^{-1/2}$ [12] позволяет предположить, что

$$C_m = C_m^0 \exp\left(-\frac{T^*}{T_s}\right),\tag{3}$$

где T^* — параметр, не зависящий от T_s . Тогда

$$\rho = \rho_0 \exp\left\{\frac{D}{d_0} \left[\left(\frac{1}{\gamma} C_m\right)^{-\frac{1}{3}} - 1\right]\right\}$$
$$= \rho_0 \left\{\exp\left\{\left[\frac{1}{\gamma} C_m^0 \exp\left(-\frac{T^*}{T_s}\right)\right]^{-\frac{1}{3}} - 1\right\}\right\}^{\frac{D}{d_0}}.$$
(4)

Используя приближение $\exp(x) \simeq 1 + x$, получаем:

$$\rho \simeq \rho_0 \left\{ 1 + \left[\frac{1}{\gamma} C_m^0 \exp\left(-\frac{T^*}{T_s}\right) \right]^{-\frac{1}{3}} - 1 \right\}^{\frac{D}{d_0}}$$
$$= \rho_0 \left[\left(\frac{1}{\gamma} C_m^0 \right) \exp\left(-\frac{T^*}{T_s}\right) \right]^{-\frac{D}{3d_0}}.$$
(5)

Для рассматриваемой модели ρ должно экспоненциально увеличиваться с уменьшением T_s : $\lg \rho = \lg \rho_0 - D/3d_0[\lg(C_m^0/\gamma) - T^*/2.3T_s]$, что согласуется с экспериментом (рис. 2).

Численные значения C_m получены с использованием концепции Мотта о минимальной металлической проводимости (σ_{\min}) [15]. Величина $\sigma_{\min} = \pi e^2/4z \hbar a [B/V_0]_{crit}^2$, где z — координационное число, a — расстояние между примесными центрами, V_0 — амплитуда случайного потенциала и B — ширина зоны [15]. Для исследуемых пленок $\sigma_{\min} \simeq 300 \,\Omega^{-1} \cdot \text{сm}^{-1}$ на 5–10 порядков больше экспериментальных значений σ . Концентрацию металлической фазы можно определить, используя значения σ_{\min} , критической концентрации металлической фазы C_m^{crit} (порог протекания) для тонкопленочных систем и данные по электропроводности пленок. Предполагая, что величина σ , близкая к σ_{\min} , возможна вблизи порога перколяции $C_m^{crit} = 0.5$, свойственного тонкопленочным образцам [13,18], и туннельный механизм является единственным механизмом электропроводности для каждого из образцов и описывается формулой $\sigma_i = \sigma_0 \exp\{-D/d_0[(C_m^{(i)}/\gamma)^{-1/3} - 1]\}$, где



Рис. 2. Зависимости удельного сопротивления, измеренного при различных температурах, от температуры осаждения T_s . Температуры измерений, К: I - 156; 2 - 204; 3 - 237; 4 - 277. На вставке: зависимость концентрации металлической фазы (C_m) от T_s .

i = 1, 2, 3, 4, была получена система уравнений

$$(C_m^{(i)})^{-\frac{1}{3}} - (C_m^{(j)})^{-\frac{1}{3}} = \frac{d_0}{D} \left(\frac{1}{\gamma}\right)^{-\frac{1}{3}} \ln\left(\frac{\sigma_j}{\sigma_i}\right),$$
 (6)

после чего графически определялись $C_m^{(i,j)}$. Значения $1/\gamma = 2$ и $D/d_0 = 6$ были выбраны при согласовании на пороге протекания туннельного (d = 0) и перколяционного $(C_m^{crit} = 0.5)$ приближений. Использовались экспериментальные значения σ при T = 277 К. В качестве σ при d = 0 была взята расчетная величина $\sigma_{\min} = 300 \ \Omega^{-1} \cdot \text{сm}^{-1}$. Из вставки к рис. 2 видно, что $C_m = 8.8 \cdot 10^{-3} \div 2.8 \cdot 10^{-2}$ экспоненциально зависит от $1/T_s$, что согласуется с (3) и рис. 2.

Край оптического поглощения является размытым (рис. 3), имея слабо искаженную урбаховскую форму $\alpha(\hbar\omega) = \alpha_0 \exp(\Gamma\hbar\omega)$, обуслов-



Рис. 3. Спектры оптического поглощения для пленок, осажденных при $T_s = 250^{\circ}$ С (2) и $T_s = 350^{\circ}$ С (1). 3 — разностные спектры $\Delta \alpha(\hbar \omega) = \alpha(T_s = 350^{\circ}$ С) – $\alpha(T_s = 250^{\circ}$ С).

ленную встроенными электрическими полями [19–22]. Коэффициент $\Gamma = d(\ln \alpha)/d(\hbar\omega) = 2.4 \div 3.7 \,\mathrm{eV^{-1}}$ близок к значениям для аморфных пленок CdGeAs² (Fe) (1.6 – 2.9 eV⁻¹) [19], содержащих в алмазоподобной матрице кластеры с металлической проводимостью. Для нелегированных аморфных поулпроводников $\Gamma = 15 \div 22 \,\mathrm{eV^{-1}}$ [15]. На кривых $\alpha(\hbar\omega)$ отсутствуют периодические изменения α (интерференционная картина, характерная для оптически однородных сред). Для углеродных пленок сглаженная интерференционная картина в спектрах является надежным свидетельством пространственной неоднородности [6] и обычно связывается с металлическими нанокластерами, встроенными в диэлектрическую матрицу [5,6]. Оптические спектры получены при $\hbar\omega < 1.4 \,\mathrm{eV}$, где отсутствует поглощение, связанное с алмазоподобной структурой, и основную роль в их формировании играют кластеры с металлической проводимостью.

Особенности в спектрах при $\hbar\omega \simeq 0.6$ и 0.8 eV, скорее всего, обусловлены возбуждением поверхностных плазмонов в металлических кластерах [5,6,23,24]. В разностных спектрах (кривая *3* на рис. 3)

дополнительно выявляются два слабых максимума при $\hbar\omega \simeq 0.7$ и 1.0 eV и участок резкого увеличения $\Delta \alpha$ при $\hbar \omega > 1.2$ eV.

Измерения термо-эдс показали, что исследуемые аморфные пленки имеют ярко выраженный дырочный тип проводимости. Абсолютные значения коэффициента Зеебека η логарифмически уменьшаются с ростом σ (вставка к рис. 1), что согласуется с поведением классических полупроводников, для которых $\eta = k/e \{\varphi(\xi) + \ln [2(2\pi m^*kT)^{3/2}/ph^3]\}$, где φ — функция $\xi = (6\rho_I/\rho_L)^{1/2}$, а ρ_I и ρ_L — удельные сопротивления, обусловленные рассеянием на примесях и на колебаниях решетки; p — концентрация дырок, m^* — эффективная масса, k — постоянная Больцмана. В упрощенном случае [25] $\varphi(\xi) \simeq 2$.

Технология исключала появление в заметных количествах неконтролируемых примесей, и наиболее вероятным источником дырочной проводимости является азот, растворимость которого повышается с ростом температуры осаждения пленок. Дырочная проводимость возможна при всех конфигурациях связей, однако σ образцов должна превышать σ_{\min} . Образование дырочного металла с участием одномерных цепочек с s p-связями, учитывая склонность к локализации носителей заряда и высокое сопротивление карбинов, следует считать невероятным [16]. Вхождение трехвалентного азота в алмазоподобные кластеры с $(s p^3)$ конфигурацией связей представляет собой классическую схему образования дырок в алмазоподобных полупроводниках, однако металлическая проводимость в этих условиях, скорее всего, невозможна. Наиболее вероятной природой металлической проводимости в исследуемых пленках мы считаем образование (под влиянием азота) малых кластеров на основе у-углерода [26]. Возникновение металлической проводимости в аморфных веществах с алмазоподобной структурой под влиянием примесей хорошо известно. Изменение локальной структуры при этом происходит с увеличением координационного числа от 4 до 12 [19,27].

Авторы признательны З.А. Самойленко за рентгеноструктурные исследования пленок.

Список литературы

- [1] Smith F.W. // J. J. Appl. Phys. 1984. V. 55. N 3. P. 764-771.
- [2] Liu A.Y., Cohen M.L. // Science. 1989. V. 245. P. 841-842.
- [3] Sjostrom H., Stafstrom S., Boman M. et al. // Phys. Rev. Lett. 1995. V. 75. N 7. P. 1336–1339.

- [4] Шемченко Е.И., Шалаев Р.В., Пашинская Е.Г. // ФТВД. 2001. Т. 11. № 2. С. 83–85.
- [5] Сморгонская Э.А., Звонарева Т.К., Иванова Е.И. и др. // ФТТ. 2003. Т. 45. В. 9. С. 1579–1589.
- [6] Иванов-Омский В.И., Криворотов И.Н., Ястребов С.Г. // ЖТФ. 1995. Т. 65.
 В. 9. С. 121–135.
- [7] Иванов-Омский В.И., Толмачев А.В., Ястребов С.Г. // ФТП. 2001. Т. 32.
 В. 2. С. 227–232.
- [8] Llie A., Ferrari A.C., Yagi T. et al. // J. Appl. Phys. 2001. V. 90. N 4. P. 2024– 2031.
- [9] Rodil S.E., Ferrari A.C., Robertson J. et al. // J. Appl. Phys. 2001. V. 89. N 10. P. 5425–5430.
- [10] Забродский А.Г., Зиновьева К.Н. // ЖЭТФ. 1984. Т. 86. В. 2. С. 727–742.
- [11] Брандт Н.Б., Демишев С.В., Дмитриев А.А. и др. // ЖЭТФ. 1984. Т. 86. В. 4. С. 1446–1460.
- [12] Мейлихов Е.З. // ЖЭТФ. 1999. Т. 115. В. 4. С. 1484–1496.
- [13] Шкловский Б.И., Эфрос А.Л. Электронные свойства легированных полупроводников. М.: Наука, 1979. 416 с.
- [14] Двуреченский А.В., Рязанцев И.А., Дравин В.А. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1986. Т. 43. В. 1. С. 46–48.
- [15] Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. М.: Мир, 1982. Т. 1. 368 с.
- [16] Демишев С.В., Пронин А.А., Глушков В.В. и др. // Псьма в ЖЭТФ. 2003. Т. 78. В. 2. С. 984–993.
- [17] Okunev V.D., Samoilenko Z.A., Abal'oshev A. et al. // Physics Letters A. 2004.
 V. 325. P. 79–85.
- [18] Ханикаев А.Б., Грановский А.Б., Клерк Ж.П. // ФТТ. 2002. Т. 44. В. 9. С. 1537–1539.
- [19] Окунев В.Д. // ФТТ. 1992. Т. 34. В. 4. С. 1263–1269.
- [20] Бонч-Бруевич В.Л. // УФН. Т. 140. В. 4. С. 583-637.
- [21] Redfield D. // Sol. State Commun. 1982. V. 44. N 9. P. 1347-1353.
- [22] Silver M., Pautmeier L., Bassler H. // Sol. State Commun. 1989. V. 72. N 2. P. 177–180.
- [23] Петров Ю.И. Физика малых частиц. М.: Наука, 1982. 359 с.
- [24] Kreibig. // J. Phys. F4. 1974. P. 999–1014.
- [25] Баранский П.И., Клочков В.П., Потыкевич И.В. Полупроводниковая электроника. Киев: Наук. думка, 1975. 704 с.
- [26] Палатник Л.С., Гусева М.Б., Габаев В.Г. и др. // ЖЭТФ. 1984. Т. 87. В. 3. С. 914–917.
- [27] Окунев В.Д., Самойленко З.А. // Письма в ЖЭТФ. 1991. Т. 53. В. 1. С. 42-45.